

## JEITA 電子実装技術標準化 活動報告会2017

～ グリーン社会実現に向けた先端実装技術 ～

日時 平成29年7月13日(木) 10:00～16:40 (受付開始 9:30～)  
 場所 芝浦工業大学 豊洲キャンパス交流棟(6階) 大講義室  
 主催 一般社団法人 電子情報技術産業協会  
 企画 JEITA/実装技術標準化専門委員会

P

rogram

司会 山本 克己 氏 テクノオフィス・ヤマモト

10:00～10:05	主催者挨拶 二宮 良次 JEITA 実装技術標準化専門委員会 委員長 (株)東芝
10:05～10:10	来賓挨拶 瀬川 雅也 氏 経済産業省 商務情報政策局情報通信機器課 課長補佐
10:10～10:30	METIプロジェクト「三次元電子モジュールの外形及び電氣的試験方法に関する国際標準化」の 取り組みについて 春日 壽夫 氏 基準認証イノベーション技術研究組合
10:30～11:00	IEC 62090『電子部品用容器包装ラベルのバーコード規格』の改訂について 高井 弘光 氏 (一財)流通システム開発センター
11:00～11:30	『はんだ接合部のリフローはんだ付け性およびプリント配線板のリフロー耐熱性試験方法』の 国際標準化活動について 杉野 成 氏 富士通アドバンステクノロジー(株)
11:30～12:00	『スルーホールリフロー実装に係る要求事項』標準化プロジェクト活動について 岩辺 雄一 氏 ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ(株)
休 憩 (昼食は各自にてお願い致します)	
13:00～13:30	SiCパワーデバイスとその応用技術の最新動向 高尾 和人 氏 (株)東芝 研究開発センター
13:30～13:45	METIプロジェクト『パワーデバイス実装に関わる国際標準化』の取り組み状況 岡本 正英 氏 パワーデバイス実装の国際標準化研究委員会 副委員長 (株)日立製作所
13:45～14:15	METIプロジェクト『パワーデバイス実装に関わる国際標準化』 ディスクリートタイプパワーデバイスWGの取り組み 高橋 邦明 氏 ディスクリートタイプパワーデバイスWG 幹事 元 エスペック(株)
14:15～14:45	METIプロジェクト『パワーデバイス実装に関わる国際標準化』 モジュールタイプパワーデバイスWGの取り組み 苅谷 義治 氏 パワーデバイス実装の国際標準化研究委員会 委員長 芝浦工業大学 教授
休 憩	
15:00～15:30	低温はんだ実装の市場動向について 萩尾 浩一 氏 (株)ニホンゲンマ
15:30～15:50	低温実装におけるウイスカ発生検証実験について(その2) 斎藤 彰 氏 ウイスカ試験方法研究会 副主査 (株)村田製作所
15:50～16:10	IEC 60068-2-82「電気・電子部品のウイスカ試験方法」改定活動 坂本 一三 氏 ウイスカ試験方法研究会 主査 オムロン(株)
16:10～16:40	はんだ接合耐久性に関わる試験方法標準化の取り組みについて 山本 剛 氏 富士通アドバンステクノロジー(株)

## ご挨拶

当協会では、「実装技術標準化専門委員会」を中心に1997年からはんだの鉛フリー化に代表されます、環境に配慮した実装技術開発活動に取り組んで参りました。また、これらの活動成果は、毎年『報告会』を開催し、広く普及を図って参りました。今年も『JEITA 電子実装技術標準化 活動報告会』として、この一年間の先端的な実装技術の検討結果をご報告させていただきます。

今回は、METIプロジェクト「三次元電子モジュールの外形及び電氣的試験方法に関する国際標準化」及び「パワーデバイス実装に関わる国際標準化」をはじめ、部品のバーコード規格改定の動向、プリント配線板はんだ接合部のはんだ付け試験方法の国際標準化の取り組み、スルーホールリフロー実装に係る標準化について等、多岐にわたるテーマについてご報告させていただきます。

他にも、省エネルギーの観点で近年注目を集めてきています低温はんだ実装の市場動向や、信頼性の観点で再度規格改定が議論されています電気・電子部品のウイスカ試験方法の改定活動状況や、「実装技術標準化専門委員会」が独自に取り組んでいる活動として、現在主流になっている錫-銀-銅系鉛フリーはんだの接合寿命予測等についての報告も行わせていただきます。関係各位におかれましてはご多用中とは思いますが、是非ご参加いただき、忌憚のないご意見、活発なご討論を賜りますようお願い申し上げます。

JEITA 実装技術標準化専門委員会 委員長 二宮 良次 [(株)東芝]

■日 時 平成29年7月13日(木) 10:00~16:40 (受付開始9:30~)

■場 所 芝浦工業大学  
豊洲キャンパス交流棟(6階) 大講義室  
東京都江東区豊洲3-7-5  
<http://www.shibaura-it.ac.jp/access/toyosu.html>

■申込方法 下記のURLに必要事項をご記入の上、お申し込みください。  
折り返し「参加申込完了メール」が自動受信されます。  
また、ご登録のご住所宛に「受講票」と「請求書」をお送り致します。  
[https://www.jeita.or.jp/cgi-bin/form\\_tss/form.cgi](https://www.jeita.or.jp/cgi-bin/form_tss/form.cgi)

■申込期限 平成29年7月6日(木) 必着

■定 員 100名  
(定員になり次第締め切らせていただきますので、お早めにお申し込みください。)

■参加費 会員 10,000円(税込)  
一般 15,000円(税込)

■配布資料 成果報告書(当日配布致します)

■お問合せ先 一般社団法人 電子情報技術産業協会  
標準化センター(塩川・澤田)  
TEL:03-5218-1059 FAX:03-5218-1078  
E-mail:tsc4@jeita.or.jp

## 会場へのアクセス



最寄駅のご案内:

東京メトロ有楽町線「豊洲駅」徒歩7分  
JR京葉線「越中島駅」2番出口より徒歩15分